

以往的
导入事例

产品开发领域是



■ = 用途

— = 特长

定制针头



耐热工艺

金属注射器

[1] × [A+B+J]

通信设备搭载产品



小口径孔稳定量产

调光部件

[1] × [A+B]

医疗用产品



钛微细加工

微型顶针

[8] × [A]

[Let's do this]
精密机械加工技术
目录

我们用 [材料] 和 [加工技术] 满足客户需求 用独创的产品实现你脑海中的蓝图











运用所有精密机械加工技术，为客户提供各种各样的产品。

通过材料和技术的融合，使产品开发有无限大的可能性。可应对客户的定制需求。

材料

- 1 SUS303
- 2 SUS304
- 3 红宝石
- 4 金刚石
- 5 TY-100
- 6 HSS
- 7 超硬合金
- 8 其他

技术

- A  微细打磨加工
- B  微细孔加工
- C  抛光加工
- D  工具内制
- E  铆接加工
- F  热接合
- G  金刚石研磨加工
- H  焊锡、黏合
(金属 + 金刚石、
金属 + 金属)
- I  微细研削加工
- J  压入加工

导入事例

产品开发领域是 ∞

|| 用途
|| 特长

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>汽车部品·水晶振荡</p>  <p>不爬胶 不堵胶 点胶均匀</p> <p>点胶针头 $[A+B+C+D]$</p> | <p>生物材料打印</p>  <p>超精密涂布</p> <p>精密点胶针头 $[1] \times [A+B+C+D]$</p> | <p>3D打印</p>  <p>难切削材料 高精度加工 可应对小口径要求</p> <p>3D打印头点胶针头 $[1 \text{ or } 8] \times [A+B+C+D]$</p> | <p>镜头模组封装</p>  <p>特殊形状</p> <p>前端超长点胶针 $[1] \times [A+B+C+D]$</p> | <p>液晶封装</p>  <p>特殊形状</p> <p>喷射针头 or $[1] \times [A+B+E]$</p> | <p>半导体装置封装</p>  <p>防止针管脱落、下沉</p> <p>多头针头 $[1] \times [A+B+E]$</p> |
| <p>液晶屏封装</p>  <p>前端耐磨损性</p> <p>红宝石针头 $[1+3] \times [A+B+F]$</p> | <p>GaN/SiC等材料切割</p>  <p>干式切割 提高芯片的集成度 控制裂纹</p> <p>金刚石划线 $[1+4] \times [A+G+H]$</p> | <p>研发用的晶片切割</p> <p>简便·便宜</p> <p>金刚石压头 $[1+4] \times [A+G+H]$</p> | <p>硬度试验测定</p>  <p>可应对各种规格</p> <p>金刚石压头 $[1+4] \times [A+G+H]$</p> | <p>水晶振荡器芯片处理</p>  <p>寿命长</p> <p>金刚石夹爪 $[1+4] \times [A+H]$</p> | <p>半导体传感器</p>  <p>寿命长</p> <p>金刚石顶针 $[1+4] \times [A+G+H+I]$</p> |
| | | | | | <p>半导体检查·测定</p>  <p>稳定量产</p> <p>顶针 $[2 \text{ or } 5 \text{ or } 6 \text{ or } 7] \times [1]$</p> |